

中材科技股份有限公司

关于申请注册发行直接债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会注册的短期融资券和私募债（非公开定向债务融资）的注册额度均已到期。根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册发行直接债务融资工具，以满足公司生产经营与投资的资金需求。

本次发行直接债务融资工具的具体方案如下：

一、发行规模：本次拟发行规模不超过人民币29亿元，并在年度贷款预算范围内实施。其中，短期融资券不超过人民币9亿元，非公开定向债务融资工具不超过人民币20亿元。

二、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

三、发行目的：公司发行直接债务融资工具募集的资金将用于补充公司及控股子公司的营运资金，偿还金融机构借款及投资等事项。

四、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在规定的的时间和额度内，根据自身资金需求状况，灵活确定融资期限，持续发行。

五、发行对象：本次申请发行的直接债务融资工具面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

六、发行利率：公司本次申请发行的直接债务融资工具按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

七、承销机构：拟根据收费水平、服务水平和工作时间等情况确定承销机构。

八、公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长薛忠民先生全权负责办理与本次发行直接债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利

益最大化的原则出发，制定本次申请发行直接债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行直接债务融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2. 聘请中介机构，办理本次申请直接债务融资工具发行申报事宜。

3. 代表公司进行所有与本次直接债务融资工具发行相关的谈判，签署与本次发行直接债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件。

4. 及时履行信息披露义务。

5. 办理与本次发行直接债务融资工具有关的其他事项。

6. 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司发行直接债务融资工具尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

上述事项尚需提请公司下一次股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十七日